

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：半导体封装用金基键合丝、带

承办人：杜连民 共 2 页 第 1 页

标准项目负责起草单位：北京达博有色金属焊料有限责任公司

电话：010-84928882

序号	标准 章条 编号	意见内容	提出单位	处理 意见	备注
1	名称	将“金扁线”改为“金带”	贵研铂业股份有限公司	采纳	
2	名称	将《半导体封装用金基键合丝及金带》改为《半导体封装用金基键合丝、带》	全国有色贵金属标准化分技术委员会	采纳	
3	名称	建议金线统一命名为 Au，与其他焊线厂家一致，便于生产作业人员核对。	南京矽邦半导体有限公司	不采纳	
4	范围	因半导体分立器件包含发光二极管，故第二段建议修改适用范围	贵研铂业股份有限公司	采纳	
5	3	增加了金基键合带的定义，删除了“AG”等符号定义	重庆材料研究院有限公司	采纳	
6	4.1	焊线的直径的单位建议用 μm （微米）作为标准，更加直观简洁，符合行业日常使用习惯	江苏长晶浦联功率半导体有限责任公司	不采纳	
7	4.1	表 2 中金扁线分为 GS-B、GW-B、TS-B 三种型号，但没有提到三者的差别，后续 5.1 表 3 中化学成分只有 GS-B 一种型号，5.3 表 9 中力学性能也没有按照型号区分	贵研铂业股份有限公司	采纳	
8	4.1	表 2 中，用途一栏中低弧键合和低弧键合的弧高范围有交叉，需区分	贵研铂业股份有限公司	不采纳	
9	4.2	金基键合丝分类混乱，使其产品标记数字表示含义混乱，需重新梳理分类及型号	全国有色贵金属标准化分技术委员会	采纳	
10	5.1	金合金丝化学成分表头“余量”改为“其他”	浙江佳博科技股份有限公司	采纳	
11	5.1	表 5 中 AG8 型的 Pd 含量建议改为 0-5，因现有市场应用的金合金线存在含金 80%且仅添加微量 Pd 元素的产品，Pd 含量 1-5%不能涵盖此种金合金线产品	贵研铂业股份有限公司	采纳	
12	5.2.1	金丝直径允许偏差范围随直径大小采取梯度规定	全国有色贵金属标准化分技术委员会	不采纳	
13	5.2.2	增加金带重量范围	浙江佳博科技股份有限公司	不采纳	
14	5.3	表 9 和表 10 伸长率的波动范围小数点保留位数应一致	贵研铂业股份有限公司	采纳	

15	5.3	对“伸长率波动范围”进行注释解释	重庆材料研究院有限公司	采纳	
16	5.3	表 10 最大伸长率建议每个规格都适当提高，例如 0.018mm 以上直径建议提高至 20%，否则将不能涵盖全部此类产品的性能，例如现有应用的部分含金 80% 的合金线伸长率会达到 15%~20%	贵研铂业股份有限公司	采纳	
17	5.3	表 9 和表 10 中使用术语“伸长率”，而表 11 使用“延伸率”，采用术语应一致	贵研铂业股份有限公司	采纳	
18	5.3	增加金带延伸率波动范围	烟台一诺电子材料有限责任公司	采纳	
19	5.5	工艺性能中没有金带的相关内容，建议增加金带的工艺性能	贵研铂业股份有限公司	采纳	
20	6.2	增加金合金丝直径及其允许偏差——重量法测量方法	紫金佳博电子新材料科技有限公司	采纳	
21	6.2	增加金合金丝直径及其允许偏差——直接测量法的测量仪器精度	广州佳博科技电子有限公司	采纳	
22	6.2	增加金带的厚度及宽度及其允许偏差测量方法	浙江佳博科技股份有限公司	采纳	
23	6.3	键合金丝和金带的拉伸速度均为 10mm/min，金合金丝的拉伸速度建议调低与金丝和金带一致、或给出一个范围，目前限定的 30mm/min、40mm/min、60mm/min 三个速度过快	贵研铂业股份有限公司	不采纳	
24	7.2	建议改为“金基键合产品应成批提交验收， 每批由同一熔炼炉次、型号、状态和规格的产品组成。”，否则不能涵盖金带	贵研铂业股份有限公司	采纳	
25	7.5.2	5.5 工艺性能中没有提到金带的工艺性能，而 7.5.2 判定内容中又把金带的工艺性能作为判定项目之一，建议前面 5.5 中增加金带的工艺性能内容，如此才能前后一致	贵研铂业股份有限公司	采纳	
26		回函同意，无意见	华天科技（南京）有限公司		
27		回函同意，无意见	江苏芯德半导体科技有限公司		
28		回函同意，无意见	欣铨（南京）集成电路有限公司		

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：12 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9 个

④没有回函的单位数：0 个。